

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2018 年向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2017〕2005 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,505,709 股。根据询价情况，本公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司最终确定向 6 名特定对象发行普通股（A 股）64,893,614 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.28 元，共募集资金总额为 731,999,965.92 元。扣除承销费、保荐费 25,440,000.00 元（其中进项税额 1,440,000.00 元）后的募集资金为 706,559,965.92 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2018 年 1 月 3 日汇入本公司在农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立的账号为 19033101040020262 人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 2,405,660.37 元后，本公司本次募集资金净额 705,594,305.55 元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕1 号）。

2. 募集资金使用计划及调整

(1) 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资金额	
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资金额	
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	杭州经济技术开发区经济发展局 杭经开经技备案〔2017〕5 号、6 号
MEMS 传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	金堂县经济科技和信息化局 金经信技改备案〔2017〕1 号
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	杭州市滨江区发展改革和经济局 滨发改体改〔2017〕003 号
合 计	80,253.00	80,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于 MEMS 传感器芯片制造扩产项目、MEMS 传感器封装项目和 MEMS 传感器测试能力提升项目，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，MEMS 传感器芯片制造扩产项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称士兰集成公司）、MEMS 传感器封装项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司），实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集成公司、成都士兰公司进行增资。

(2) 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

1) 根据公司 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	70,559.43
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	30,568.43
MEMS 传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	20,000.00
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00
合 计	80,253.00	80,000.00	70,559.43

2) 根据公司 2019 年 11 月 8 日第七届董事会第五次会议和 2019 年 11 月 25 日 2019

年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，基于产线升级、进一步提高募集资金使用效率等原因，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况对原募投项目的建设期、投资金额等进行调整，同时增加 8 吋芯片生产线二期项目和特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目作为新增的募集资金投资项目，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

原募投项目	总投资额	变更后募投项目	调整后募集资金投入金额	建设期
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	70,559.43	一、年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	30,559.43	由 2 年调整至 7 年
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	30,568.43	其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	10,568.43	
MEMS 传感器封装项目	20,000.00	MEMS 传感器封装项目	10,000.00	
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	MEMS 传感器测试能力提升项目	9,991.00	
		二、8 吋芯片生产线二期项目	30,000.00	5 年
		三、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	10,000.00	3 年
合 计	70,559.43		70,559.43	

其中，8 吋芯片生产线二期项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称士兰集昕公司）、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目实施主体为本公司孙公司成都集佳科技有限公司（以下简称集佳科技公司）。

3. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	70,559.43
截至期初累计发生额	项目投入	B1	70,595.99
	利息收入净额	B2	1,607.56
本期发生额	项目投入	C1	712.09
	利息收入净额	C2	11.42
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,308.08
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,618.98
部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金[注]		E	870.33
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	
实际结余募集资金		G	
差异		H=F-G	

[注] 系募投项目全部结项，剩余募集资金 870.33 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金

(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2533 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,660,231 股，发行价为每股人民币 51.80 元，共计募集资金 112,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）2,490.00 万元和财务顾问费（不含税）200.00 万元后的募集资金为 109,510.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）311.23 万元后，公司本次募集资金净额为 109,198.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕532 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	109,198.77
截至期初累计发生额	项目投入	B1	97,064.57
	利息收入净额	B2	796.44
本期发生额	项目投入	C1	12,993.62
	利息收入净额	C2	65.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	110,060.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	862.26
部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金[注]		E	0.05
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	
实际结余募集资金		G	
差异		H=F-G	

[注] 系募投项目结项，剩余募集资金 0.05 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金

(三) 2023 年向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募集

资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603 号）。

2. 募集资金使用计划及调整

(1) 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资净额	
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	钱塘区杭州钱塘新区行政审批局 2204-330114-89-02-524827
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	厦门市海沧区工业和信息化局 2207-350205-06-02-858369
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	金堂县发展和改革局川投资备 〔2210-510121-04-01-381195〕 FGQB-0490 号
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	
合 计	1,005,000.00	650,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期），不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司士兰集昕公司、SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称厦门明镓公司）、汽车半导体封装项目（一期）项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰公司，实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明镓公司、成都士兰公司进行增资。

(2) 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，

对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	160,000.00
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,000.00
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	110,000.00
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	146,306.11
合 计	1,005,000.00	650,000.00	491,306.11

3. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	491,306.11
截至期初累计发生额	项目投入	B1	190,624.70
	利息收入净额	B2	565.69
本期发生额	项目投入	C1	83,890.86
	利息收入净额	C2	1,817.23
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	274,515.56
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,382.92
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金		E	100,000.00
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	119,173.46
实际结余募集资金		G	119,173.46
差异		H=F-G	

二、募集资金管理情况

（一）2018 年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发（2023）193号）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2018年1月23日与东方证券承销保荐有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下

沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，本公司分别和士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司于2018年2月、2018年2月、2019年12月、2020年9月与东方证券承销保荐有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州市东新支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、中国农业银行股份有限公司金堂县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司在募集使用募集资金时已严格遵照执行。根据公司于2022年12月21日披露的《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司更换了持续督导保荐机构，东方证券承销保荐有限公司未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司承担。公司与中信证券股份有限公司、各募投项目实施主体、银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司在募集使用募集资金时已严格遵照执行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司及子公司募集资金专户均已销户。

(二) 2021 年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司于2021年9月26日在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体士兰集昕公司以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储。本公司并连同独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司和士兰集昕公司于2022年1月10日与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、士兰集昕公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司及士兰集昕公司募集资金专户均已销户。

(三) 2023年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《管理办法》，本公司对募集资

金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2023年12月11日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月3日，公司及厦门明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月19日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、厦门明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	19033101040036623	922,629,712.33	募集资金专户
厦门明镓公司	国家开发银行厦门市分行	35200109000000000059	2,867,352.48	募集资金专户
成都士兰公司	国家开发银行四川省分行	51100100000000000625	266,237,579.96	募集资金专户
合 计			1,191,734,644.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2018 年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(3) 募集资金结余及节余募集资金使用情况

募集资金投资项目“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”已于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”予以结项,并将项目结余募集资金金额（以资金转出当日银行结息后实际金额

为准)用于永久补充流动资金,将转出至自有资金账户,用于公司日常生产经营及业务发展。公司于 2023 年 5 月 17 日将结余资金转出永久补充流动资金 212.83 万元,并将募集资金账户销户。

募集资金投资项目“年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目”及“8 吋芯片生产线二期项目”已于 2024 年 10 月达到预定可使用状态,公司将募集资金投资项目“年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目”及“8 吋芯片生产线二期项目”予以结项,并将项目结余募集资金金额 (以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金,将转出至自有资金账户,用于公司日常生产经营及业务发展。公司于本期将结余资金转出永久补充流动资金 657.50 万元,并将募集资金账户销户。

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 2021 年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(3) 募集资金结余及节余募集资金使用情况

募集资金投资项目“8 吋芯片生产线二期项目”已于 2024 年 10 月达到预定可使用状态,公司将募集资金投资项目“8 吋芯片生产线二期项目”予以结项,并将项目结余募集资金金额 (以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金,将转出至自有资金账户,用于公司日常生产经营及业务发展。公司于本期将结余资金转出永久补充流动资金 0.05 万元,并将募集资金账户销户。

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 2023 年向特定对象发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

(2) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2024 年 2 月 1 日第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,885.82 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 150.97 万元。

(3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用 100,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目变更情况详见本专项报告一(一)2(2)2之说明。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此说明。

- 附件：1. 2018 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表
2. 2021 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表
3. 2023 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表
4. 变更募集资金投资项目情况表

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日

附件 1

2018 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				70,559.43		本年度投入募集资金总额					712.09	
变更用途的募集资金总额				40,000.00		已累计投入募集资金总额					71,308.08	
变更用途的募集资金总额比例				56.69%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年 产 能 8.9 亿 只 MEMS 传感器扩产项目	是	80,000.00	30,559.43	未作分期承诺	712.09	31,219.44	660.01	102.16	2024 年 10 月	2024 年该项目实现销售收入 25,000.16 万元，实现销售毛利-856.62 万元，实现净利润-4,536.73 万元	否 [注 1]	否
8 吋芯片生产线二期项目	是		30,000.00	未作分期承诺		30,236.17	236.17	100.79	2024 年 10 月	2024 年该项目实现销售收入 85,157.96 万元，实现销售毛利 7,037.34 万元，实现利润总额 3,617.78 万元	否 [注 2]	否
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	是		10,000.00	未作分期承诺		9,852.47	-147.53	98.52	2022 年 12 月	2024 年该项目实现销售收入 40,481.96 万元，实现销售毛利 4,058.42 万元，实现净利润 2,705.50 万元	否 [注 3]	否
合 计	—	80,000.00	70,559.43	—	712.09	71,308.08	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	年产能 8.9 亿 只 MEMS 传感器扩产项目建设期由 2 年调整至 7 年，详见本专项报告一(一)2(2)2)之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告三(一)1 (3)之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目预计正常生产年度新增净利润 9,849 万元，本期未达预计效益主要系受市场竞争影响，产品价格有所下降，同时原材料价格持续高位运行，成本较高，综合导致毛利率下降。

[注 2]：8 吋芯片生产线二期项目预计正常生产年度新增利润总额 20,757.36 万元，本期未达预计效益主要系受市场竞争影响，产品价格有所下降，同时原材料价格持续高位运行，成本较高，综合导致毛利率下降。

[注 3]：特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目预计正常生产年度新增净利润 4,460 万元，本期未达预计效益主要系受市场竞争影响，产品价格有所下降，同时原材料价格持续高位运行，成本较高，综合导致毛利率下降。

附件 2

2021 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				109,198.77		本年度投入募集资金总额					2.80	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					110,060.99	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额 (1)	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
8 英寸集成电 路芯片生产 线二期项目	否	53,098.77		未作分期 承诺	2.80	53,543.72	444.95	100.84	2024 年 10 月	2024 年该项目实 现 销 售 收 入 85,157.96 万元， 实 现 销 售 毛 利 7,037.34 万元，实 现 利 润 总 额 3,617.78 万元	否	否
偿还银行贷款	否	56,100.00				56,517.27	417.27	100.74		不适用		
合 计	—	109,198.77		—	2.80	110,060.99	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“三、2024年度本次交易募集资金的实际使用情况”之“1、募集资金使用情况对照表”之“（3）募集资金结余及节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	无

注：8吋芯片生产线二期项目预计正常生产年度新增利润总额 20,757.36 万元，本期未达预计效益主要系本年度下游客户需求结构性调整，产品价格有所下降，同时原材料价格持续高位运行，成本较高，综合导致毛利率下降。

附件 3

2023 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				491,306.11		本年度投入募集资金总额					83,890.86	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					274,515.56	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额(1)	截至期末 承诺投入 金额	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否 发生重 大变化
年产 36 万片 12 英寸芯片生 产线项目	否	300,000.00	160,000.00	未作分期 承诺			-160,000.00		2026 年 12 月	不适用	不适用	否
SiC 功率器件 生产线建设项 目	否	75,000.00	75,000.00	未作分期 承诺	30,484.67	74,803.26	-196.74	99.74	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
汽车半导体封 装项目（一期）	否	110,000.00	110,000.00	未作分期 承诺	53,406.19	53,406.19	-56,593.81	48.55	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	165,000.00	146,306.11	未作分期 承诺		146,306.11		100.00		不适用		

合 计	—	650,000.00	491,306.11	—	83,890.86	274,515.56	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					根据公司于 2024 年 11 月 25 日第八届董事会第三十次会议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”和“汽车半导体封装项目（一期）”是公司完善高端功率半导体领域的重要战略布局，项目建设整体规模较大、资金需求较高。在项目实施过程中，受项目资金到位时间、行业发展和市场竞争情况、IDM 企业各环节产线配套建设情况等因素的影响，公司部分产线建设进度有所放缓。综合考虑当前市场环境，募投项目的实施进度、实际建设情况、项目建设周期以及公司业务发展需求（包括应对外部环境变化进行产品技术升级和产能结构调整）等因素，同时为更好控制投资风险，基于审慎性原则，将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三(三)1 (2)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告三(三)1 (3)之说明							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

附件 4

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	截至期末计 划累计投入 金额	本年度 实际投入 金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
8 吋芯片生产线 二期项目	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩 产项目	30,000.00	未作分期 承诺		30,236.17	100.79	2024 年 10 月	2024 年该项目实现销售收 入 85,157.96 万元，实现销 售毛利 7,037.34 万元，实现 利润总额 3,617.78 万元	否	否
特色功率模块及 功率器件封装测 试生产线项目		10,000.00	未作分期 承诺		9,852.47	98.52	2022 年 12 月	2024 年该项目实现销售收 入 40,481.96 万元，实现销 售毛利 4,058.42 万元，实现 净利润 2,705.50 万元	否	否
合 计	—	40,000.00	—		40,088.64	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本专项报告一(一)2(2)2之说明						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						